

- [3] Wittenberg L.J., Santarius J.F., Kulcinski G.L. - Fusion Technology, 1986, v. 10, N 2, p. 167-171.
- [4] Kulcinski G.L., Schmitt H.H. The Moon: an abundant source of clean and safe fusion fuel for the 21-st century. 11-th international scientific forum on fueling the 21st century. 1987, UWEDM-730.
- [5] Козлов Б.Н. - Атомная энергия, 1962, т. 12, в. 3. с. 238-240.
- [6] Гуськов С.Ю., Ильин Д.В., Левковский А.А. и др. - Атомная энергия, 1987, т. 63. в. 4, с. 252-255.
- [7] Голант В.Е., Жилинский А.Н., Сахаров И.Е. Основы физики плазмы - М.: Атомиздат, 1977, 384 с.
- [8] Пастухов В.П. Классические потери плазмы в открытых адиабатических ловушках в кн.: Вопросы теории плазмы. - М.: Энергоатомиздат, 1984, вып. 13, с. 160-204.

Поступило в Редакцию
2 августа 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 20

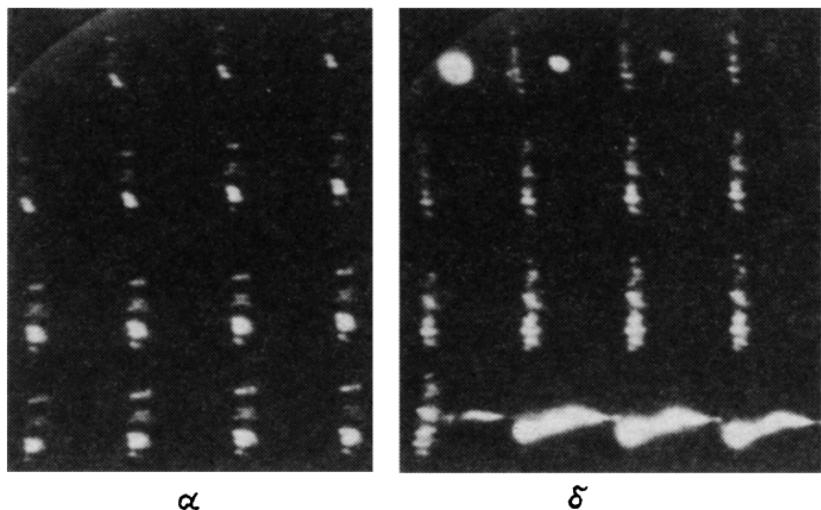
26 октября 1988 г.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ИСКРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА

Д.А. Мазалов, А.П. Напартович,
А.Ф. Паль

Для выяснения природы шнурования объемного разряда при повышенных давлениях представляет интерес исследовать реакцию такого разряда на внешние возмущения проводимости, плотности или потенциала. Так, в [1], объемные возмущения проводимости в плазменном столбе стационарного самостоятельного разряда создавались вспомогательным импульсным разрядом между головками подвижного зонда. Аналогичный способ применялся и в несамостоятельном разряде [2]. Удобно использовать для этой цели лазерный пробой, вызванный сфокусированным в разрядном промежутке импульсным излучением. При этом легко изменяется локализация искры и отсутствуют неконтролируемые возмущения от присутствия в плазме самих зондов.

Мощный импульс излучения за короткое время (~ 20 нс) создает шар плазмы с концентрацией, заметно превышающей характерную для несамостоятельного разряда ($\sim 10^{12}$ см $^{-3}$). Кроме того, лазерная искра сильно разогревает газ, что приводит к формированию ударной волны и разлету газа и плазмы [3].



α

δ

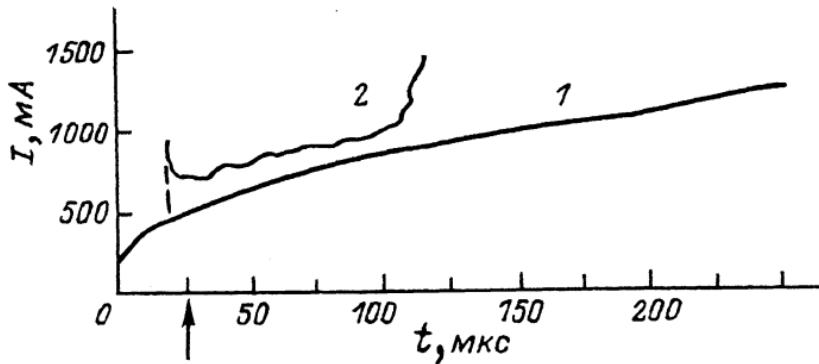
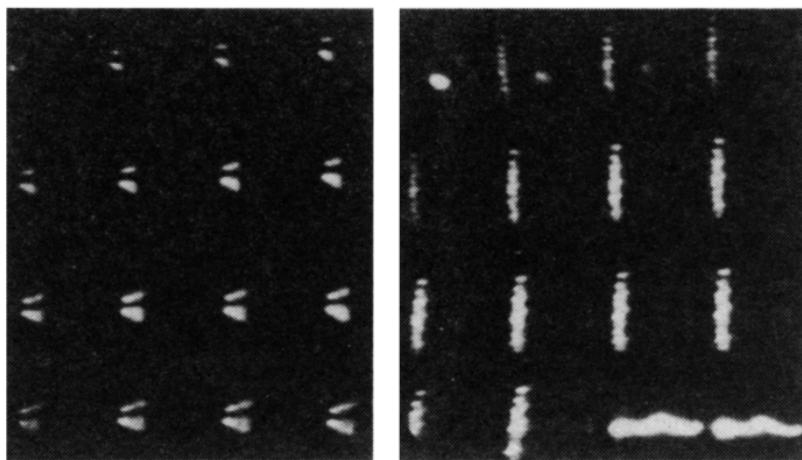


Рис. 1. Осциллограммы тока разряда при напряжении $U = 3$ кВ без лазерной искры (1) и с искрой (2) и соответствующие им ЭОП-граммы. Стрелкой отмечен момент запуска лупы времени. Порядок следования кадров слева-направо, сверху-вниз. Слева — катод, справа — анод. Длительность кадра 3 мкс, пауза между кадрами 3 мкс.

Нашей целью было изучение влияния лазерной искры на шунрование несамостоятельного разряда в азоте и прилипательную неустойчивость в смеси $O_2 + Ar$.

Эксперименты проводились на установке, аналогичной [4]. Несамостоятельный разряд контролировался электронным пучком с энергией 120 кВ и плотностью тока $100 \text{ мкА}/\text{см}^2$. Расстояние между электродами 1 см, площадь электродов 1 см^2 . В центре разрядного промежутка с помощью линзы с фокусным расстоянием



a

б

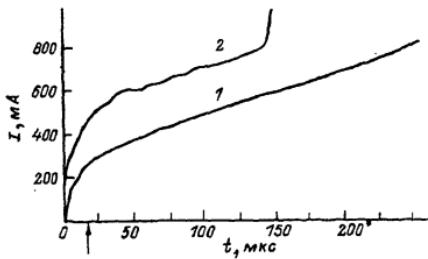


Рис. 2. То же, что и на рис. 1, но с лазерной искрой до начала разряда. Длительность кадра 4 мкс, пауза 4 мкс.

3 см фокусировалось излучение неодимового лазера с энергией 120 мДж и длительностью импульса 15–20 нс. Разряд фотографировался 16-кадровой лупой времени с минимальной длительностью кадра 0.5 мкс и паузой между кадрами 2 мкс. Все эксперименты проводились при атмосферном давлении.

На рис. 1 приведены осциллограммы тока разряда и фотографии участка несамостоятельного разряда в азоте с лазерным пробоем и без. Моменту лазерного пробоя соответствует резкий рост тока разряда, его максимум растет с ростом энергии лазерного излучения. Свечение от пробоя заполняет за время не больше 0.5 мкс (минимальная экспозиция одного кадра), т.е. весь разрядный промежуток, а затем быстро уменьшается в диаметре, сопровождаясь уменьшением тока разряда. Через 10–13 мкс ток выходит на

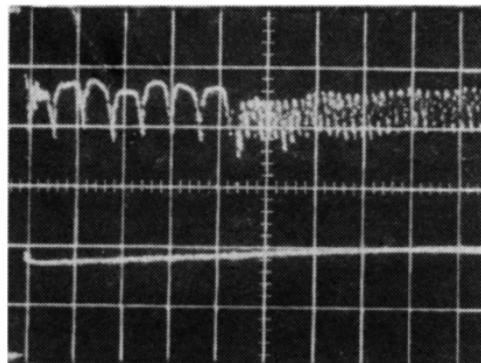


Рис. 3. Осциллограммы тока разряда (верхний луч, развертка 50 мА/дел) и напряжения (нижний луч, 500 В/дел) в смеси 1% $O_2 + Ar$. Развертка 10 мкс/дел.

квазистационарный уровень, зависящий от приложенного напряжения и дальше нарастает со скоростью, характерной для несамостоятельного разряда без возмущения. На прикатодном свечении влияние лазерного пробоя проявляется в увеличении числа катодных пятен и уменьшении длины проросших шнурков в одни и те же моменты времени от начала разряда, т.е. свечение прикатодной области становится более однородным.

Через время, уменьшающееся с ростом энергии лазерного излучения и времени задержки лазерной искры относительно начала разряда происходит очередной резкий рост тока. Этот рост сопровождается распространением от одного из электродов шнура, замыкающего промежуток между электродом и центральной областью. Возможно одновременное перемыкание обоих приэлектродных слоев, в этом случае рост тока еще быстрее. Завершается этот процесс шнуркованием всего разрядного промежутка.

Такие же характерные особенности наблюдаются, когда лазерный пробой происходит раньше включения импульса напряжения (рис. 2).

В смеси 1% $O_2 + Ar$ прилипательная неустойчивость проявляется в форме колебаний тока с периодом, соответствующим движению между электродами прилипательных доменов. Слабое свечение разряда не позволило исследовать динамику процесса с помощью пульсации времени. На осциллограммах тока разряда наблюдается увеличение частоты колебаний тока после лазерного пробоя в 4–5 раз (рис. 3).

Большая часть наблюдаемых явлений может быть объяснена в рамках трехслойной модели плазмы, в которой выделены два приэлектродных слоя толщиной примерно 1/4 см и слой плазмы в области газовой каверны, возникшей на месте лазерной искры (толщина ~ 0.5 см).

В начальный момент после оптического пробоя можно считать, что сопротивление среднего слоя плазмы обращается в нуль. Ска-

чок тока, вызванный пробоем, определяется величиной напряжения на этом слое непосредственно перед пробоем. Из осцилограмм тока следует, что при напряжениях 3 кВ во время искры ток возрастает в два раза, что свидетельствует о примерно постоянном поле в промежутке. При напряжении ~ 2 кВ относительный скачок тока несколько меньше. Это можно объяснить тем, что большая часть напряжения приходится на катодную область. Уменьшение тока после окончания оптического пробоя обусловлено, главным образом, распадом плазмы в области искры. Характерное время распада согласуется с обычным рекомбинационным временем.

Уровень тока, получающегося по завершении распада плазмы в области искры, зависит, главным образом, от приложенного напряжения. При малых напряжениях ток выходит практически на тот же уровень, что был бы в отсутствие искры. Можно полагать, что основное падение напряжения как при наличии искры, так и без нее, приходится на прикатодную область. Фотографии с ЭОП'а показывают, что искра при малых напряжениях не влияет существенно на вид катодных пятен. С ростом напряжения количество катодных пятен растет, а падение напряжения на этой области уменьшается. В результате после распада плазмы в области искры ток выходит на более высокий уровень, чем в ее отсутствие, при этом искра заметно влияет на катодные пятна. Последующее шнурование разряда также протекает по-различному при малых и больших полях. При малых вначале закорачивается шнуром прикатодный промежуток, затем шнуруется оставшаяся часть разряда. При больших полях шнур образуется почти одновременно по всей длине с некоторым опережением в прианодной области.

Особенности шнурования объясняются неравномерным распределением потенциала между прикатодным и прианодным слоем. В частности, при больших полях ($U = 3$ кВ), избыточное напряжение распределяется более равномерно между приэлектродными слоями. В этом случае дополнительные эксперименты продемонстрировали, что время шнурования после искры близко к времени шнурования исходного разряда с удвоенным напряжением на нем.

Дополнительные аргументы в пользу изложенной выше упрощенной картины дают эксперименты в смеси $Ar + O_2$. Изменение периода колебаний тока в этой смеси после оптического пробоя в 4 раза (рис. 3) соответствует примерно уменьшенному пробегу прилипательных доменов, существующих в этом газе, на толщину слабо возмущенной плазмы ($\sim 1/4$ см). В области газовой каверны вследствие высокой газовой температуры оказываются процессы разрушения отрицательных ионов $O^-O_3^-$ [4], что приводит к распаду в этой области доменов.

Таким образом, совокупность экспериментальных данных качественно хорошо объясняется в рамках трехслойной модели плазмы с учетом специфики прикатодного слоя. Реально имеющаяся радиальная неоднородность плазмы приводит к локализации шнура в центре разряда. Однако, поскольку видимый на фотографиях ЭОП шнур образу-

ется, как правило, за несколько микросекунд до замыкания всего промежутка, можно полагать, что определяющую роль в процессе шнурования играют объемные процессы.

Л и т е р а т у р а

- [1] Акишев Ю.С., Волчек А.М., Напарто-вич А.П. и др. - ТВТ, 1987, т. 25, № 4, с. 630-635.
- [2] Персианцев И.Г., Рахимов А.Т., Сутина Н.В., Тимофеев М.А. - Физика плазмы, 1983, т. 9, № 3, с. 637-641.
- [3] Кондрашов В.Н., Родионов Н.Б., Ситников С.Ф., Соколов В.И. - ЖТФ, 1986, т. 56, № 1, с. 89-96.
- [4] Демьянин Л.В., Кочетов И.В., Напарто-вич А.П. и др. - Письма в ЖТФ, 1986, т. 12, № 14, с. 849-853.
- [5] Месси Г. Отрицательные ионы, М.: Мир, 1979.

Поступило в Редакцию
18 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 20

20 октября 1988 г.

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ $GaAs$, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ АЗОТА И КИСЛОРОДА ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

И.А. Ельяшевич, А.Б. Журавлев,
Ю.В. Мараконов, Е.Л. Портной,
А.Е. Федорович

Глубокая имплантация ионов кислорода в $GaAs$ позволяет создать эффективный насыщающийся поглотитель, быстродействие которого составляет величину порядка нескольких пикосекунд при дозах облучения $\sim 10^{12}$ ион/ cm^2 [1, 2].

Свойства такого поглотителя определяются областями разупорядочения, образующимися вдоль треков имплантируемых и вторичных ионов. В частности, время жизни неравновесных носителей заряда и, значит, быстродействие поглотителя зависят от размеров аморфных областей, созданных ионной бомбардировкой, и расстояния между ними, так как рекомбинация носителей в данном случае определяется безызлучательными процессами и время жизни равно времени диффузии носителей до аморфных областей [3].

Сведения об объеме образующихся аморфных областей можно получить, изучая спектры пропускания света арсенидом галлия вблизи края поглощения в зависимости от дозы облучения. С ростом дозы